

上海南芯半导体科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。

2025 年上半年，公司制定的行动方案主要进展及成效情况如下：

一、专注主营业务，提升经营质量

2025 年上半年，公司聚焦主营业务，持续加大研发投入，加强技术产品创新、加深客户壁垒、整合供应链优势等全面强化公司市场竞争力，具体成效如下：

1、加大研发投入，增厚研发团队成果

2025 年上半年，公司研发投入 282,452,014.60 元，较上年同期增长 54.62%；研发投入总额占营业收入比例为 19.21%，较去年同期提高 4.60%。截至 2025 年 6 月 30 日，公司研发人员数量增至 756 人，较上年同期增长 71.82%，研发人员数量占公司员工总数的比例为 68.35%，较 2024 年半年度期末研发人员数量占公司员工总数的比例提高 3.45%。公司获得新增授权专利 50 项，累计获取专利 165 项。公司新增 7 项核心技术，分别是压电微泵驱动技术、GaN 驱动控制及其集成技术、三电平变换技术、摄像头马达驱动技术、多相控制技术、多模式触控检测及低功耗唤醒技术和 RISC-V 核心处理器及配套工具链技术，均为自主研发。

2025 年下半年公司将持续加强技术沉淀，加大研发投入以满足公司不断拓宽产品领域和业务场景的发展需求，并积极拓宽引进人才渠道，高效整合研发资源，优化人才队伍，为公司的规模化增长和长远发展打下坚实基础，预计 2025 年全年研发投入占营业收入的比例不低于 15.00%。

2、丰富产品型号，积极拓展新兴应用领域

2025 年上半年，公司推出了多款新品，持续丰富产品布局。在高端消费电

子领域，公司推出了压电驱动芯片、内置 MOS 升降压充电芯片、高集成度移动电源 SoC 等产品。其中，压电驱动芯片驱动的微泵液冷方案可大幅提升移动智能终端散热性能，填补了国产技术空白，除了液冷应用，该芯片还可广泛适用于触觉反馈、固态按键等压电驱动应用，在智能手机等设备中均能实现低功耗和高精度的控制，未来亦有望拓展至汽车、工业领域。在汽车电子领域，公司推出了车规级高速 CAN/CAN FD 收发器、全新车规级升降压转换器及高边开关等产品，进一步扩大了公司在车载电源、驱动、传输领域的业务版图。此外，公司推出的全新 GaN 合封 PFC，也已逐步切入工业电源领域，适用于显示器电源模组、LED 驱动、电动工具和 e-Bike 充电器等对体积、效率和功耗均有严格要求的工业级电源应用场景。

2025 年上半年，公司消费电子领域的显示电源管理芯片、锂电管理芯片、无线充电管理芯片和汽车电子芯片等产品市场拓展获得一定成效，国内市场占有率获得提升，进一步加强公司在消费电子电源管理领域核心竞争力的同时推进公司在汽车电子业务板块的发展。2025 年下半年，公司将围绕核心发展战略，凭借自身强大的研发和产品创新能力，不断迭代更新产品，丰富产品矩阵，同时积极投资资源布局新兴应用领域的芯片产品，拓展工业、AI、机器人等领域的市场，支持公司长期稳健发展。

3、积极拓展市场，业绩稳健增长

2025 年上半年，公司实现营业收入 1,470,146,606.81 元，较去年同比增长 17.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 122,660,470.10 元，较去年同期下降 40.21%；受产品结构和市场竞争的综合影响，2025 年上半年公司综合毛利率较去年同期下降 4.32%，实现综合毛利率 36.97%。

2025 年下半年，公司将继续以市场需求为导向，持续密切关注终端需求的演变，深刻理解终端用户对充电产品的实际需求，增强客户粘性，探索更高效、更稳定的客户合作模式以及开发国内新客户，提升国内市场的市占率。同时进一步加强建立海外销售渠道建设，加快海外销售业务的爬坡起量，打开海外业务的发展空间。

4、加强产业并购，加快公司发展步伐

模拟芯片行业作为半导体产业的核心赛道，近年来呈现"强者恒强"的竞争格局。面对下游汽车电子、工业智能化等市场需求的爆发式增长，以及工艺迭代、研发投入持续攀升的行业趋势，通过战略并购整合资源正成为头部企业加快发展

步伐的关键路径。2025 年上半年，公司完成了以现金方式收购珠海昇生微电子有限责任公司 100%股权的并购交易，交易对价合计不超过人民币 16,000 万元。本次收购促进公司高效整合标 MCU 芯片设计和开发的技术能力，有助于公司深化掌握嵌入式内核，具备自主可控 IP 和工具，进一步强化硬件、算法、软件等嵌入式领域的技术优势，有利于公司的产品研发。同时通过本次收购，公司将扩充在嵌入式领域的研发、技术与客户服务能力，公司将拥有更为完备的模拟与嵌入式产品结构，提升产品能力的齐备性和竞争力，为客户提供处理器芯片+模拟芯片+系统软件的解决方案，有望进一步提升公司的品牌价值。未来公司将持续加强产业并购，加速公司业务布局拓展。

二、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力

2023 年 4 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币 25.40 亿元。上市以来，公司使用募集资金投入“高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目”、“高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目”、“汽车电子芯片研发和产业化项目”、“测试中心建设项目”及补充流动资金等项目。截至报告期期末，IPO 募集资金使用总体投入进度已达到 69.79%，截至本公告披露日，IPO 募集资金使用总体投入进度已达到 71.49%

在募集资金投入公司研发的背景下，公司募集资金投资项目是在公司现有业务、技术积累的基础上进行的技术升级与业务拓展，项目的实施有助于增强公司的技术研发能力，以实现公司产品的升级换代及推广，进一步巩固和提升公司在电源管理领域的市场地位，有助于全面提升公司生产能力、研发能力和盈利能力，实现公司的可持续发展。公司本次募集资金投资项目的实施将助力公司不断丰富产品矩阵，提升在消费电子领域的优势，同时拓展在工业和汽车电子领域的应用，有助于增强公司的核心竞争力，符合公司未来经营战略发展方向。

2025 年上半年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。具体如下：

1、高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目

该项目计划使用 IPO 募集资金投入 4.57 亿元，已经投入 4.46 亿元。截至 2025 年上半年期末，项目投入进度达到 97.61%。2025 年下半年，公司将持续按计划

推动项目建设，该项目基于现有电荷泵架构，研发新型充电架构，解决传统控制架构面临的效率和温升瓶颈，降低系统设计复杂度，提升系统可靠性，进一步提高超大功率充电的功率等级。面向低功耗、高精度的应用需求进行相应锂电管理芯片开发，以目前在工业及消费类应用为基础，丰富锂电管理芯片类型以适用更广泛的终端产品。基于当前的无线充电管理芯片，拓展更多无线充电模拟前端 IC 和 SoC 型 MCU，布局 Qi2 无线充电等，进一步丰富无线充电产品类别以适应各类终端产品。针对单节和多节锂电池充电应用，在公司现有的通用充电管理芯片基础上，进一步迭代、研发更高性能的充电管理芯片，提高充电精度和截止电流精度，减小待机功耗，提高对充电过程中电池电压、电流、温度等信号监测的精度，提供更高效更可靠的充电方案。通过本项目的实施，公司将进一步拓宽产品的终端应用范围，同时优化产品成本，提升产品竞争力。

2、高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目

该项目计划使用 IPO 募集资金投入 2.27 亿元，已经投入 1.87 亿元。截至 2025 年上半年期末，项目投入进度达到 82.30%。2025 年下半年，公司将按计划持续推动项目建设，基于现有集成 GaN 直驱的控制 IC 和集成 GaN 器件的 AC-DC 产品基础上，进一步开发支持第三代功率半导体器件的大功率充电芯片。迭代现有 PD 和 DPDM 控制器系列产品，以支持更多快充协议，推出更多的具有快充协议控制器的 PHY 控制器和 SoC 型 MCU 产品。同时，基于 SoC 型 MCU 拓展出通用型 MCU 系列产品，丰富产品矩阵。完善现有 AC-DC 控制芯片的同时，推出 PFC 系列、软开关系列等相关系列产品，以支持更高功率等级，提高功率密度。通过本项目的实施，公司将进一步强化在开关电源领域的技术深度，保持技术先进性，拓宽产品应用领域。

3、汽车电子芯片研发和产业化项目

该项目计划使用 IPO 募集资金投入 3.35 亿元，已经投入 2.35 亿元。截至 2025 年上半年期末，项目投入进度达到 70.30%。2025 年下半年，公司将持续按计划推动项目建设，本项目基于现有的车载充电 IC 做进一步迭代，提高耐压和输出功率，集成更广泛的充电协议，支持更大功率车载充电，同时开发车规级 DC-DC 芯片和智能驱动芯片，支持智能配电和域控制器的应用。通过本项目的实施，公司对现有产品品类进行横向扩充，增强公司在电源及电池管理芯片市场的整体竞争优势。

4、测试中心建设项目

该项目计划使用 IPO 募集资金投入 3.09 亿元，已经投入 0.36 亿元。2025 年上半年，公司综合考虑市场和行业的发展变化，为满足公司发展战略的规划，将原募投项目“测试中心建设项目”变更成新募投项目“芯片测试产业园建设项目”，新募投项目拟购置土地自建芯片测试厂房并投入相关测试设备（包括 FT 测试、CP 测试、烧录测试设备等）以支持公司产品生产过程的成品检测和新项目量产过程的工程验证检测。新募投项目的建设将支持公司研发的消费、车规和工业类芯片的生产测试需求。此次募投项目的变更能够提高募集资金的使用效率，提高公司产品测试技术能力；能够更有效地控制产品质量，降低不良率和售后服务成本，提升公司产品质量管理水平；同时自主可控的测试产线有利于保障公司产品稳定供应；能够提升公司的核心竞争力，支持公司经营规模的提升，尤其是车规业务规模的发展，符合公司长期发展战略。

三、持续完善公司治理，筑牢高质量发展根基

公司高度重视治理水平的提升，2025 年上半年，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关要求，持续推进公众公司的规范运作，进一步完善和优化公司各项治理和管理制度，依法全面履行信息披露义务，积极承担企业社会责任，提高规范运作水平，筑牢高质量发展根基。

1、持续优化公司各项治理制度。2025 年上半年，公司积极落实中国证券监督管理委员会的要求，按照《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的要求，建立了《上海南芯半导体科技股份有限公司市值管理制度》，并严格按制度推进公司市值管理相关工作。

2、公司将持续加强内部控制建设。2025 年上半年，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规及规范性文件以及公司章程制定了《上海南芯半导体科技股份有限公司内部控制评价制度》，以规范公司内部控制评价工作，确保内部控制体系有效运行，提升公司治理水平。

3、深度落实董事、监事和高级管理人员的证券法规培训。2025 年上半年，

公司内部安排专业人员开展了规范运作相关培训，同时组织董监高人员积极参与相关培训课程，加强学习证券市场相关法律法规，强化合规意识，切实推动公司高质量可持续发展。

四、加强投资者沟通交流，建立长期互信通道

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过接听投资者热线、上证 E 互动、开设企业官网投资者关系专区、组织业绩说明会和股东会等方式，加强投资者对公司生产经营状况的了解，与投资者建立良好互动。切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为股东提供准确的投资决策依据。

2025 年上半年，公司将继续加强投资者沟通交流，积极建立与资本市场的有效沟通机制，持续打造健康、透明的投资者关系体系，不断完善沟通渠道，丰富交流方式，通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办 2 次投资者线上交流会，并组织投资者调研接待不低于 12 次、通过投资者热线、E 互动平台、电子邮箱、策略会等多种形式与投资者加强交流频次，积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，消除信息壁垒，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者对公司的认同感和信心。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

五、注重投资者回报，共享高质量发展成果

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。

2025 年 4 月 25 日公司召开第二届董事会第五次会议，2025 年 5 月 26 日公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股数为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。截至公司 2024 年度利润分配预案披露之日，公司总股本为 425,457,743 股，扣除回购专户股数 1,752,889

股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 84,740,970.80 元（含税）。2024 年度公司现金分红总额 126,928,536.30 元（含 2024 年半年度现金分红金额 42,187,565.50 元）。2024 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 50,013,489.26 元，现金分红和回购金额合计 176,942,025.56 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 57.65%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司于 2025 年 6 月 13 日完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象和预留授予部分第一类激励对象第一个归属期的股份登记工作，新增股份 245,168 股，公司股本总数由 425,457,743 股增加至 425,702,911 股。基于上述总股本变动情况，公司调整拟派发现金分红总额为 84,790,004.40 元（含税）。

未来，公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，将密切关注监管规则对分红的要求，评估多次分红的可行性，在业绩增长的同时，合理优化现金分红方案，加强股东回报，让股东切实感受公司的发展成果。

六、强化管理层与股东的利益共担共享

2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，拟向激励对象授予 300 万股第二类限制性股票，其中首次授予 244.9815 万股，授予价格为 18.53 元/股，预留授予 55.0185 万股。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理

2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意为满足条件的 11 名首次授予部分第二类激励对象办理 90,243 股限制性股票归属和同意为满足条件的 15 名预留授予部分第一类激励对象办理 154,925 股限制性股票归属。

2025 年 5 月 15 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 15 日为首次授予日，以 18.53 元/股的授予价格向符合条件的 277 名激励对象授予 239.4394 万股限制性股票。

2025 年 6 月 20 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象和预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属的 245,168 股股票上市流通。

公司对激励计划设定了公司层面营收收入的业绩考核要求，同严密的个人层面绩效考核结合，能有效地将股东利益、公司利益和管理层及公司核心骨干的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司发展质量，增强投资者回报。

此外，公司为高级管理人员制订了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策。高管薪酬由基础薪资、津贴及绩效奖金组成。公司依据经营业绩及盈利状况，结合个人绩效目标完成情况进行评估，确定高管的绩效奖金。绩效奖金与公司及个人绩效挂钩。公司绩效指标包括销售额、毛利润、净利润、产品开发、客户拓展情况、投产计划、生产质量、研发项目、组织人才等，对公司经营进行全面评估。个人绩效亦根据高管的个人工作情况与业绩目标完成情况等多方面综合进行评定。2025 年下半年，公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成

公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日